证券代码：301308　　证券简称：江波龙　　公告编号：2026-128

深圳市江波龙电子股份有限公司

关于公司近期生产经营情况及加强回购与分红等措施的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近期公司及公司所在行业板块股价波动较大，为使投资者更好地了解公司生产经营情况，深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）现自愿披露相关情况如下：

一、公司经营业绩稳步提升，积极进行股东回报

公司目前生产经营一切正常， 2026 年前三季度，公司实现的营业收入和净利润同比明显增长，公司各项经营指标健康度进一步提升。公司始终以自研芯片、自研软件架构为技术引领，不断寻求差异化发展路径，在产品与技术创新方面不断取得突破。

在市值管理和股东回报方面，公司于 2026 年 9 月 8 日至 2026 年 9 月 18 日区间，通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份 2,290,604 股，回购价格区间为 328.04~365.38 元/股，占公司 A 股总股本的 0.53%，成交总金额为约 8 亿元。

2026 年以来，为提升上市公司投资价值，已经完成第一次及正在实施第二次中期分红方案。第二次中期分红方案实施完成后，公司 2026 年累计分红金额将达到 12.69 亿元，超过最近三年累计分红金额总数。

二、未来展望

作为一家综合型半导体存储品牌企业，公司坚定的对产品、技术、品牌等方面维持着高投入。目前已经推出了覆盖 SSD、UFS、eMMC、USB、SD Card 五个场景的多款自研主控芯片，搭配自研固件算法，从底层技术上赋予存储器产品更优异的性能，形成明显的技术壁垒。

公司在自研主控芯片的基础之上，重点布局端侧 AI 业务。在 AI 技术以及算力基础设施建设积累了巨大进步之后，端侧 AI 已经初步展现出良好的发展势头。

公司的 SSD 主控芯片和 UFS 主控芯片，结合搭配公司独有的存储智能软件架构，可以运用于端侧 AI 如 PC、手机设备以实现本地大模型运行。目前已经与 AMD、高通、紫光展锐及其他全球领先主芯片厂商开展合作，表现出了较为广阔的发展潜力。

公司将持续开拓海外业务，提升高端品牌影响力。公司国际消费类存储品牌 Lexar（雷克沙）销售收入和巴西 Zilia 子公司的销售收入保持良好上升势头，Lexar（雷克沙）预计 2026 年全年有望突破 10 亿美元大关，巴西 Zilia 子公司的销售收入截止至 2026 年 10 月 31 日已经超过 10 亿美元（未经审计），更标志着公司全球化能力达到新的高度。

2026 年 1 月-9 月，公司企业级业务实现营收超过 40 亿元，较去年同期大幅增长。依托于自有的研发技术能力，公司企业级业务发展较为稳健。在存储介质改善和颗粒改善等方面与终端互联网云厂商和其他重要客户进行携手研发，具备较强的技术壁垒，以及更好的、更长久的发展潜力。

总体来看，AI 技术的持续演进仍然是主要趋势，除算力中心外，AI 技术在端侧（包括车规级应用以及具身智能等场景）的应用将会不断深入，创造新的需求。公司对行业发展充满信心。

三、通过回购及分红等措施，进一步加强股东回报

未来，公司将进一步加强投资者关系管理，持续向投资者传递公司投资价值与未来发展规划，增进投资者对公司的认同感，构建长期稳定、良性沟通的投资者关系，增强投资者信心，切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益，持续提升公司在资本市场形象。同时公司将持续通过现金分红、股份回购等方式增强投资者的获得感。

中国人民银行近日提出将加力实施股票回购增持再贷款政策，公司将深入研究相关政策，同时结合公司资金情况、市场走势等，充分运用政策工具，继续通过股票回购等方式，维护公司价值和广大投资者利益。

公司将根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》和公司已披露的《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》规定，在综合考虑自身发展阶段、盈利水平、

重大资金支出安排的基础上，进一步与投资者共享发展成果，加强分红力度，缩短投资者获得回报的周期。

特此公告。

深圳市江波龙电子股份有限公司董事会

2026 年 11 月 6 日